

TSSOP-SMD Multiadapter (thin shrink small outline package)



RE933

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. AU und Lötstopmaske
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für 10 verschiedene TSSOP
- pitch 0,65 mm / 0,50 mm
- vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Größe 58,90 x 120,10 mm

Modul-Nr	Pitch	mil	Pin/Anz.	Gehäusegröße (mm)
RE933-01	0,65	22,5	8	4,4 (173 mil)
RE933-02	0,65	22,5	14	4,4 (173 mil)
RE933-03	0,65	22,5	16	4,4 (173 mil)
RE933-04	0,65	22,5	20	4,4 (173 mil)
RE933-05	0,65	22,5	24	4,4 (173 mil)
RE933-06	0,65	22,5	28	4,4 (173 mil)
RE933-07	0,65	22,5	32	6,1 (240 mil)
RE933-08	0,50	19,6	38	4,4 (173 mil)
RE933-09	0,50	19,6	48	6,1 (240 mil)
RE933-10	0,50	19,6	56	6,1 (240 mil)